

# BGA返修台KID-R600

产品名称	BGA返修台KID-R600
公司名称	深圳市华凯迪科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道河西社区城西工业区9栋5F
联系电话	0755-27673122 13510942096

## 产品详情

### 1.概述

KID-R600是一款带光学对位系统，光学镜头、上部加热头由电机驱动、软件控制的拆焊一体化返修工作站，用于拆焊各类封装形式芯片。

### 2.产品描述

#### 2.1产品特点

热风头和贴装头一体化设计，步进电机驱动，具有自动焊接和自动拆焊功能；

上部热风头为新型一体化加热方式，具有红外、热风混合加热特点，升温速率快，可使被拆BGA和周边BGA产生较大的温差，在拆焊过程中不影响到周边BGA，此功能最适合芯片与芯片间距离小的电子元件；

下部热风,底部红外，三个温区独立加热.加热时间和温度全部在触摸屏上显示；

移动式底部预热面积大，PCB夹具可X,Y轴灵活调节，最大夹板尺寸可达550\*500mm；

底部强力横流风扇制冷，降温迅速可靠；

彩色光学视觉系统,具分光双色、放大和微调功能，含色差分辨装置，自动对焦、软件操作功能，22倍光学变焦，可返修最大BGA尺寸70\*70mm，可返修最小BGA尺寸1\*1mm;

嵌入式工控电脑，触摸屏人机界面。PLC控制，实时温度曲线显示，可显示设定曲线和实测曲线，可对测

温曲线进行分析；

内置真空泵， 角度60° 旋转，精密微调贴装吸嘴；

8段升(降)温+8段恒温控制，可海量存储温度曲线，在触摸屏上即可进行曲线分析；

吸嘴可自动识别吸料和贴装高度，压力可控制在10克范围内；

多种尺寸合金热风喷嘴，易于更换，可360° 任意角度定位。

彩色光学视觉系统由电机自动移动。

配置测温端口，具有实时温度监测与分析功能。

采用带有定位刻度的治具上完成自动取放芯片，只要在操作屏上输入芯片大小，上部风头会自动吸取或拆放芯片中心位置，更加适合批量生产。

具有固态运行显示功能,使控温更加安全可靠;

该机可在不同地区不同环境的温度下自动生成SMT标准温度拆卸曲线，无需人工设置机器曲线，有无经验操作者均能使用，实现机器智能化。